

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年8月23日(2012.8.23)

【公開番号】特開2010-28112(P2010-28112A)

【公開日】平成22年2月4日(2010.2.4)

【年通号数】公開・登録公報2010-005

【出願番号】特願2009-163528(P2009-163528)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)

B 24 B 37/22 (2012.01)

【F I】

H 01 L 21/304 6 2 2 F

B 24 B 37/00 W

【手続補正書】

【提出日】平成24年7月5日(2012.7.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

上面、底面、および少なくとも2つの包み込みタブを有するサブパッド層；

上側および底側を有する裏当てプレート；並びに

サブパッド層を裏当てプレートに取り付けるのを容易にするように設計された少なくとも2つの凹み領域を有する犠牲層；を含み、

サブパッド層が裏当てプレートの上側に配置されており、犠牲層が裏当てプレートの底側に配置されており、並びに少なくとも2つの包み込みタブが裏当てプレートの底側まで伸びている；

化学機械研磨パッド製造用組立品。

【請求項2】

サブパッド層の上面に平行線パターンで適用された未硬化の反応性ホットメルト接着剤をさらに含む、請求項1に記載の化学機械研磨パッド製造用組立品。

【請求項3】

少なくとも2つの包み込みタブの取り外しを容易にするために、サブパッド層が目打ちを有する、請求項1に記載の化学機械研磨パッド製造用組立品。

【請求項4】

少なくとも2つの包み込みタブの底面と裏当てプレートの底側との間に配置されている感圧接着剤をさらに含み、当該感圧接着剤が少なくとも2つの包み込みタブを裏当てプレートの底側に固定している、請求項1に記載の化学機械研磨パッド製造用組立品。

【請求項5】

サブパッド層の底面に適用された感圧接着剤および剥離ライナーをさらに含み、当該剥離ライナーは感圧接着剤と裏当てプレートの上側との間に配置されており、剥離ライナーが少なくとも2つの包み込みタブにはなく、サブパッド層の底面に適用された感圧接着剤が少なくとも2つの包み込みタブを裏当てプレートの底側に固定している、請求項1に記載の化学機械研磨パッド製造用組立品。

【請求項6】

犠牲層と裏当てプレートの底側との間に配置されている感圧接着剤の層をさらに含み、

当該感圧接着剤が犠牲層を裏当てプレートの底側に固定している、請求項1に記載の組立品。

【請求項7】

少なくとも2つの包み込みタブが犠牲層の少なくとも2つの凹み領域にはまり込んでいる、請求項1に記載の組立品。

【請求項8】

少なくとも2つの包み込みタブが犠牲層の少なくとも2つの凹み領域とかみ合っている、請求項1に記載の組立品。

【請求項9】

上面、底面および目打ちされている少なくとも2つの包み込みタブを有するサブパッド層；

上側および底側を有する裏当てプレート；

裏当てプレートにサブパッド層を取り付けるのを容易にするように設計された少なくとも2つの凹み領域を有する犠牲層；

サブパッド層の上面に平行線パターンで適用された未硬化の反応性ホットメルト接着剤；

サブパッド層の底面に適用された第1感圧接着剤；

剥離ライナー、ここで第1感圧接着剤はサブパッド層の底面と剥離ライナーとの間に配置されており、剥離ライナーは第1感圧接着剤と裏当てプレートの上側との間に配置されており、剥離ライナーは目打ちされている少なくとも2つの包み込みタブにはなく、第1感圧接着剤を裏当てプレートの底側に対して露出させている；並びに、

犠牲層と裏当てプレートの底側との間に配置されており、第1感圧接着剤と組成が同じかまたは異なっている第2感圧接着剤；

を含み、

サブパッド層は裏当てプレートの上側に配置されており；

目打ちされている少なくとも2つの包み込みタブは裏当てプレートの底側まで伸びており；

目打ちされている少なくとも2つの包み込みタブを経て裏当てプレートの底側に対して露出した第1感圧接着剤は、目打ちされている少なくとも2つの包み込みタブを裏当てプレートの底側に固定しており；並びに

第2感圧接着剤は犠牲層を裏当てプレートの底側に固定している；
化学機械研磨パッド製造用組立品。

【請求項10】

研磨層を提供し；

上面、底面および少なくとも2つの包み込みタブを有するサブパッド層；上側および底側を有する裏当てプレート；裏当てプレートにサブパッド層を取り付けるのを容易にするように設計された少なくとも2つの凹み領域を有する犠牲層；平行線パターンでサブパッド層の上面に適用された未硬化の反応性ホットメルト接着剤；を含み、サブパッド層が裏当てプレートの上側に配置されており、犠牲層が裏当てプレートの底側に配置されており、少なくとも2つの包み込みタブが裏当てプレートの底側まで伸びている、化学機械研磨パッド製造用組立品を提供し；

研磨層とサブパッド層との間に配置される未硬化の反応性ホットメルト接着剤で、研磨層と化学機械研磨パッド製造用組立品とを積層させて、積層物を形成し；

積層物に軸方向の力を適用し；

未硬化の反応性ホットメルト接着剤を硬化させて、サブパッド層と研磨層との間に反応性ホットメルト接着剤結合を形成し；

サブパッド層から少なくとも2つの包み込みタブを分離させ；並びに

サブパッド層に結合した研磨層を有するサブパッド層を裏当てプレートから取り外す；ことを含む、化学機械研磨パッドを製造する方法。